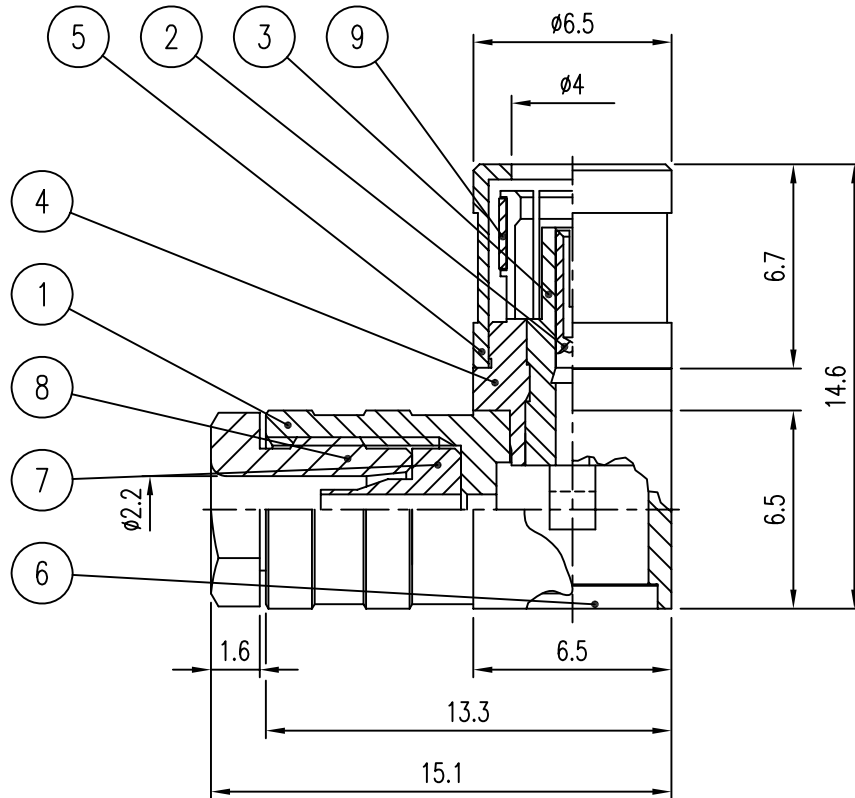


1										수 정 내 용				
가공										부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
ST(기준)										1	[첨변처리No.201108-0004] BODY 면취부 길이 설변 및 가이드부 추가	감안철	윤재호	2011. 8. 11.
ST(개선)														



주 기

1. 재질

- 1.1 몸체 : KS-D-5101 C3604BD-F 패삭황동봉
- 1.2 접촉핀 : ASTM-B196의 C17300, 베릴륨동
- 1.3 절연체 : SAE-AS1946또는 동등한 재료 (PTFE 테프론)

2. 보호피막처리 : 접촉핀은 MIL-DTL-45204, type II, class I

몸체는 MIL-DTL-45204, type II, class 00에 따라 처리 할 것

3. 전기적특성

- 3.1 특성 임피던스 : 50Ω
- 3.2 절연저항 : 1,000MΩ 이상
- 3.3 접촉저항 : 6.0mΩ 이하
- 3.4 D.W.V : AC 750Vrms 이상에서 1분간 견딜 것

4. 모든 덧살 및 날카로운 모서리를 제거할 것

5. 모든 치수는 참고 치수임

9	SPRING RING	1	BeCu C17300	Gold Plate	DSR00004-5/1 (R3001)
8	SCREW CAP	1	MBsBD C3604BD-F	산무 Gold Plate	DBN00019-5/1 (P3006)
7	INSRET	1	MBsBD C3604BD-F	산무 Gold Plate	DIS00022-5/1 (M3005)
6	COVER	1	MBsBD C3604BD-F	산무 Gold Plate	DCO00042-5/2 (L2003)
5	CAP	1	MBsBD C3604BD-F	산무 Gold Plate	DCU00022-5/1 (K3002)
4	JACK	1	MBsBD C3604BD-F	산무 Gold Plate	DJA00033-5/1 (J3005)
3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00335-N/1 (H3016)
2	CONTACT	1	BeCu C17300	Gold Plate (1.27μm)	DCT00361-5/1 (E3011)
1	BODY	1	MBsBD C3604BD-F	산무 Gold Plate (0.508μm)	DBD01444-5/1 (D3015)

대체가능재질	품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 * ±0.1 ,** ±0.05	년월일	2011. 8. 11.				
재질	승인	J. H. YOUN				
열처리	검도					
보호피막처리	재도	I. C. KIM				
	작성부서	연 구 소				
	척도 4/1	단위 mm	중량	도명		
				SMB50 CABLE PL RG178(50Ω)		
				도번 CN00206-7/1		
				K315-145-000		

* 조립 받침 JIG : DEQ01229-1/1

